

次世代高速通信 ワーキンググループ

2024年4月設立予定



【設立趣旨】

次世代高速通信分野を対象に企業間ネットワーク作りとその活性化をめざす。WG参加者の活動を通して次世代高速通信業界を盛り上げていくことをめざします。

【活動骨子】

- ①WG参加企業の交流会
- ②講演会（勉強会）
- ③次世代高速通信分野の業界マップの検討
 - ・低誘電損失型プリント配線板、材料・プロセス、電磁波シールドアンテナなどに関連する製造装置・評価装置、評価等の業界に係る情報の収集と発信（シーズ政情）
 - ・実装構成部材である「高周波化」「オール光化」「超低消費電力化」に関連した、材料・プロセスに要求する機能等に係る情報の収集と発信（ニーズ情報）
- ④展示会出展

【参加資格】

- ★日本法人であること
- ★おおさかグリーンTECH会員であること（無料）



【万博を契機としたものづくり中小企業の技術開発支援事業】



地方独立行政法人
大阪産業技術研究所 森之宮センター
〒536-8553大阪市城東区森之宮1-6-50

<https://orist.jp/>

Beyond 5G分野で材料・プロセスに要求する機能は？

求められる機能

超高速/大容量、超低遅延、超多数同時接続、
超低消費電力、自律性、拡張性、超安全/信頼性

構成部材

★高周波化関連

テラヘルツ波半導体デバイス、低損失伝送線路/誘電体材料、
アレイアンテナ/アンテナ一体型実装材料、メタマテリアル、
電波遮断材料

★オール光化関連

高集積光モジュール、光電子融合技術/光導波路、次世代光無線
(RoF)、次世代光ファイバ (マルチコア/マルチモード)

★超低消費電力化関連

超低消費電力半導体、3次元実装、高熱伝導絶縁材料

材料・プロセス

★現時点で認識している材料要求機能

低誘電損失型プリント配線基板とその材料 (樹脂、接着剤等
化学品、回路形成材料等)、電磁波シールド、アンテナとそ
の材料、関連する製造装置・評価装置、信頼性評価・検査等

★更なる要求機能は何か？

【スコープ】

上記の材料・プロセス、実装構成部材等の業界に係る情報の収集と発信
ご関心ある方は下記までご連絡下さい！



地方独立行政法人
大阪産業技術研究所 森之宮センター



06-6963-8006 加藤・内村
kato.yutaka@orist.jp